联络人
投资人关系
+886 3397 5999 ext. 1204
ir@winfoundry.com

稳懋半导体公告 2018 年第二季自结财务报告

2018 年 7 月 20 日

稳懋半导体，全球最大砷化镓晶圆代工服务公司，已于今(20)日公告 2018 年第二季自结财务报告。

2018 年第二季财务概况

- 本季合并营收新台币 45.67 亿元，较前季增加 2%，较去年同期增加 20%
- 本季合并毛利率为 32.4%，较前季减少 1.7 个百分点；
  本季营业净利率 20.7%，较前季减少 2.6 个百分点
- 本季营业净利为新台币 9.46 亿元，较前季减少 9%，较去年同期减少 5%
- 本季税后净利为新台币 9.05 亿元，较前季增加 24%，较去年同期增加 24%；
  每股盈余为新台币 2.16 元，前季为新台币 1.74 元

2018 年第三季展望

下列对于未来展望的表述是基于对现况的预期，但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。请参阅后附之「免责声明」。

- 部分客户进入库存调整期，需求不如往年同期强劲，第三季营收可能较第二季下滑一成左右。
- 预计第三季毛利率约为 low thirties 的水平。

管理者评论

"2018 年第二季稳懋营收符合公司之前的预估，较前一季成长 2%，年成长则达到 20%的水平。总计 2018 年上半年营收较去年同期成长 27%，排除 3D 感测的相关营收，上半年来自于智能型手机微波通讯业务实质年成长仍有两位数的水平。虽然产能利用率与上一季相当，但第二季毛利率受到产品组合的影响，低于公司的预估，较前一季下滑 1.7 个百分点。第二季及上半年的 EPS 分别为新台币 2.16 元及 3.90 元，分别优于去年同期的 1.85 元及 3.08 元。

稳懋身处在与智能型手机高度联结的供应链当中，而智能型手机产业又是一个变化快速的产业，尽管每年的季节性波动都不尽相同，不过稳懋的策略一直是善用多元的技术及客户组合，让公司全年业绩维持稳定成长，并积极开发新的市场运用及下一代所需技术，加上产能上的优势，以维持领先地位。也因为如此，稳懋已在手机功率放大器及 3D 感测组件晶圆代工具领先地位，我们持续对 3D 感测光电组件及未来 5G 行动通讯的长期发展持续深具信心。

展望第三季，部分客户进入库存调整期，需求不如往年同期强劲，第三季营收可能较上季下滑一成左右，预期第三季毛利率约为low thirties 的水平。"

关于稳懋半导体

稳懋半导体成立于 1999 年，位于林口华亚科技园区，是全球首座以六英吋晶圆生产砷化镓微波集成电路(GaAs MMIC)的专业晶圆代工服务公司。稳懋拥有完整的技术团队及最先进的砷化镓微波晶体管及集成电路制造技术及生产设备，客户群除了全球射频集成电路设计公司(RFIC Design Houses)外，并致力吸引与全球整合组件制造(IDM)大厂合作。在制程技术发展方面，稳懋以多元化及领先为原则，期能提供客户最完整的服务。在无线宽带通讯的微波高科技领域中，稳懋目前提供两大类砷化镓晶体管制程技术：异质接面双极性晶体管(HBT)和应变式异质接面高迁移率晶体管(pHEMT)，二者均为最尖端的制程技术。在光通讯及 3D 感测领域中，稳懋更以 MMIC 生产技术为基础，提供光电产品的开发与生产制造。

免责声明

本数据可能包含对于未来展望的表述。该类表述是基于对现况的预期，但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。因此实际结果将可能明显不同于表述内容。除法令要求外，公司并无义务因应新信息的产生或未来事件的发生主动更新对未来展望的表述。